

天津中环半导体股份有限公司

关于面向合格投资者公开发行公司债券更名的公告

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]732 号，核准公司面向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。截至本公告出具日，公司已发行 19 中环 01 余额 4.5 亿元、19 中环 02 余额 6 亿元，本次批文项下剩余 19.5 亿元未发行。

由于本次债券分期发行涉及跨年，本期债券发行为本次债券项下的第三期发行，按照公司债券命名惯例，本期债券名称为“天津中环半导体股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。

本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《天津中环半导体股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《天津中环半导体股份有限公司 2018 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《天津中环半导体股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司公开发行人民币公司债券承销协议》及债券受托管理人与公司签署的其他相关协议。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券更名的公告》之盖章页）



天津中环半导体股份有限公司

2020年6月11日

（本页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券更名的公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2020年6月11日

